



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所
关于广东鼎泰高科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的

补充法律意见书（三）

二〇二二年三月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-31层, 邮编: 100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于广东鼎泰高科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

补充法律意见书（三）

致：广东鼎泰高科技股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人申请首次公开发行不超过5,000万股普通股并在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市（以下简称“本次发行上市”）事宜的专项法律顾问。

就发行人本次发行上市事宜，本所律师已于2021年6月22日出具了《北京市中伦律师事务所关于广东鼎泰高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《北京市中伦律师事务所关于为广东鼎泰高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市出具法律意见书的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”），于2021年9月17日出具了《北京市中伦律师事务所关于广东鼎泰高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”），于2021年12月6日出具了《北京市中伦律师事务所关于广东鼎泰高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）。

根据深交所上市审核中心出具的《关于广东鼎泰高科技股份有限公司申

请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（审核函〔2022〕010202号）（以下简称“《落实函》”）和相关法律法规及规范性文件的规定，本所律师就《落实函》涉及的相关事项进行了核查，现根据有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本补充法律意见书。

本所在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》中发表法律意见的前提、假设和声明同样适用于本补充法律意见书。

本所同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行上市申请所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担责任。

释 义

本补充法律意见书中，除下列词语的含义存在变化情况外，其他简称与《法律意见书》及《律师工作报告》一致。

简称	指	全称或涵义
本补充法律意见书	指	本所出具的《北京市中伦律师事务所关于广东鼎泰高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（三）》

一、《落实函》第 1 问 行业政策对发行人的影响

申请文件及问询回复显示，发行人下游业务主要系 PCB 相关行业，受国家半导体产业政策的影响较大。

请发行人分析说明近年来国家半导体产业政策的变动情况，半导体产业政策调整对发行人持续经营能力的影响，未来会否发生重大不利变化。

请保荐人、发行人律师发表明确意见。

回复：

一、补充说明

（一）发行人分析说明近年来国家半导体产业政策的变动情况

半导体产业作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会信息化的重要基础，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。国家为推动国内半导体产业的发展，增强信息产业的创新能力和国际竞争力，出台了一系列鼓励扶持政策，为半导体产业建立了优良的政策环境，具体如下：

序号	文件名称	发布时间	发布单位	主要内容
1	《“十四五”智能制造发展规划》	2021年4月	工信部	规划指出，推进智能制造，关键要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链和产业集群等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效的智能制造系统。到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。
2	《中华人民共和国工业和信息化部国家发展改革委财政部国家税务总局公告》（2021年第9号）	2021年4月	工信部、发改委、财政部、国税总局	将《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》国发[2020]8号》第二条所称国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件明确。

序号	文件名称	发布时间	发布单位	主要内容
3	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	2021年3月	发改委	纲要指出，需要集中优势资源攻关多领域关键核心技术，其中集成电路领域包括集成电路设计工具开发、重点装备和高纯靶材开发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破，先进存储技术升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展。
4	《关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技[2021]413号）	2021年3月	发改委、工信部、财政部、海关总署、国税总局	明确了享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业条件和标准。
5	《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》	2020年12月	财政部、国家税务总局、发改委、工信部	国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。
6	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	2020年7月	国务院	国家鼓励的先进封装测试企业给与财税、投融资、研发、进出口人才、知识产权等方面的优惠政策。
7	《广东省加快半导体及集成电路产业发展的若干意见》	2020年2月	广东省人民政府办公厅	该政策明确指出，要积极发展封测、设备及材料，完善产业链条，积极推进缺陷检测设备、激光加工设备等整机设备的研发生产。
8	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	2019年10月	发改委	鼓励类产业中包括球栅阵列封装（BGA）、插针网格阵列封装（PGA）、芯片规模封装（CSP）、多芯片封装（MCM）、栅格阵列封装（LGA）、系统级封装（SiP）、倒装封装（FC）、晶圆级封装（WLP）、传感器封装（MEMS）等先进封装与测试。
9	《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》	2019年5月	财政部、税务总局	依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

序号	文件名称	发布时间	发布单位	主要内容
10	《粤港澳大湾区发展规划纲要》	2019年2月	国务院	该政策明确指出要培育壮大战略性新兴产业，高性能集成电路领域在此战略性新兴产业中，进而有利于半导体器件专用设备制造业的发展。
11	《战略性新兴产业分类（2018）》	2018年11月	国家统计局	将集成电路制造业列为国家战略性新兴产业，对应《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2017）中的半导体器件专用设备制造。
12	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》	2017年1月	发改委	重点支持电子核心产业，包括集成电路芯片封装，采用SiP、MCP、MCM、CSP、WLP、BGA、Flip Chip（倒装封装）、TSV等技术的集成电路封装。
13	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	2016年12月	国务院	启动集成电路重大生产力布局规划工程，实施一批带动作用强的项目，推动产业能力实现快速跃升。加快先进制造工艺、存储器、特色工艺等生产线建设，提升安全可靠CPU、数模/模数转换芯片、数字信号处理芯片等关键产品设计开发能力和应用水平，推动封装测试、关键装备和材料等产业快速发展。
14	《“十三五”国家科技创新规划》	2016年7月	国务院	攻克14纳米刻蚀设备、薄膜设备、掺杂设备等高端制造装备及零部件，突破28纳米浸没式光刻机及核心部件，研制300毫米硅片等关键材料，研发14纳米逻辑与存储芯片成套工艺及相应系统封测技术，开展75纳米关键技术研究，形成28-14纳米装备、材料、工艺、封测等较完整的产业链，整体创新能力进入世界先进行列。
15	《中国制造2025》	2015年5月	国务院	将集成电路作为“新一代信息技术产业”纳入大力推动发展的重点领域，着力提升集成电路设计水平，掌握高密度密封及三维微组装技术，提升封装产业和测试的自主发展能力，形成关键制造设备供货能力。

（二）半导体产业政策调整对发行人持续经营能力的影响，未来会否发生重大不利变化

根据全球半导体贸易统计组织的数据，2020 年全球半导体销售额达到 4,403.89 亿美元，同比增长 6.81%。随着国内经济不断发展以及国家政策层面对半导体行业的大力支持，我国半导体产业快速发展，产业规模迅速扩大，技术水平显著提升，有力推动了国家信息化建设。根据中国半导体行业协会统计，2020 年中国集成电路产业销售额为 8,848.00 亿元，同比增长 17.00%。

IC 载板主要应用于半导体封装环节，目前半导体行业景气度升至高位，带动 IC 载板需求提升。根据 Prismark 数据，2020 年 IC 载板行业产值已达到 102 亿美元，预计 2025 年 IC 载板行业产值达到 162 亿美元，2020-2025 年的复合增长率为 9.69%。报告期内公司客户深南电路、兴森科技等 IC 载板行业知名厂商的相关业务收入高速增长，根据公开披露信息，深南电路 IC 载板业务 2020 年实现营业收入 15.44 亿元，同比增长 32.67%，收入占比为 13.31%，2021 年上半年实现营业收入 10.95 亿元，同比增长 45.79%，收入占比为 18.62%；兴森科技 IC 载板业务 2020 年实现收入 33,615.89 万元，同比增长 13%，收入占比为 8.33%，2021 年上半年实现收入 29,543.76 万元，同比增长 111.06%，收入占比为 12.46%。

半导体产业作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会信息化的重要基础，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。结合《“十四五”智能制造发展规划》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等政策，未来一段时间内国家仍将持续积极推动半导体产业的发展，相关政策在短期内发生重大不利变化的风险较小。

公司的钻针、铣刀等产品属于 PCB 加工制造专用的耗材，PCB 广泛应用于通信、消费电子、汽车、医疗器械、工业控制等电子信息产业，具有广阔的市场空间和良好的发展前景。IC 载板等高端 PCB 为半导体产业链不可或缺的一环，未来即使国内半导体行业政策的支持力度发生变化，对整个 PCB 行业乃至电子信息产业的市场需求影响预计较为有限。公司作为 PCB 刀具龙头企业，与

国内外知名 PCB 生产厂商建立了长期稳定的合作关系，并且公司产品种类丰富、产品型号齐全、应用领域范围广，大大提升公司应对政策风险的能力，确保能够通过调整产品结构、营销组合等方式来稳步推进公司的发展。

综上，国家一系列鼓励扶持政策不断推动半导体产业的发展，带动 IC 载板市场需求以及相关厂商经营业绩的提升，为公司钻针等产品提供了更为广阔的市场空间；半导体产业政策短期内发生重大不利变化的风险较小，即使未来相关政策发生调整，对整个电子信息产业及 PCB 行业的影响预计较为有限，且公司应对政策风险的能力较强，未来公司持续经营能力受到重大不利影响的可能性较小。

发行人已在招股说明书“第四节 风险因素”之“三、经营风险”中补充披露如下：

“（二）行业政策风险

发行人钻针、铣刀等产品属于 PCB 加工制造专用的耗材，PCB 为电子信息产业中重要的组成部分，主要应用于 5G、新能源汽车、半导体等领域。PCB 行业及相关应用领域均受到国家产业政策的大力支持，行业发展前景良好，但随着市场环境逐步成熟，市场化程度逐步提高，市场规模扩大，国家相关产业政策未来存在调整的可能性，有可能对公司业务的发展造成一定的影响。”

二、核查情况

（一）核查程序

就上述问题，本所律师主要履行了以下核查程序：

查阅并了解半导体行业的行业法规、产业政策、研究报告及统计数据；查阅公开披露信息，访谈公司技术、销售人员以及公司主要客户，了解 IC 基板生产环节对钻针等刀具产品的应用，分析半导体产业政策情况对于公司持续经营能力的影响。

（二）核查结论

经核查，本所律师认为：

国家为推动国内半导体产业的发展，增强信息产业的创新能力和国际竞争力，出台了一系列鼓励扶持政策，为半导体产业建立了优良的政策环境，带动 IC 载板市场需求以及相关厂商经营业绩的提升，为公司钴针等产品提供了更为广阔的市场空间；半导体产业政策短期内发生重大不利变化的风险较小，公司应对政策风险的能力较强，未来公司持续经营能力受到重大不利影响的可能性较小；发行人已在招股说明书中补充完善相应风险提示。

本补充法律意见书正本叁份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

【以下无正文】

（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于广东鼎泰高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（三）》之签字盖章页）



北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人： 张学兵
张学兵

经办律师： 许志刚
许志刚

经办律师： 张扬
张扬

经办律师： 黎晓慧
黎晓慧

二〇二二年 三月 一日